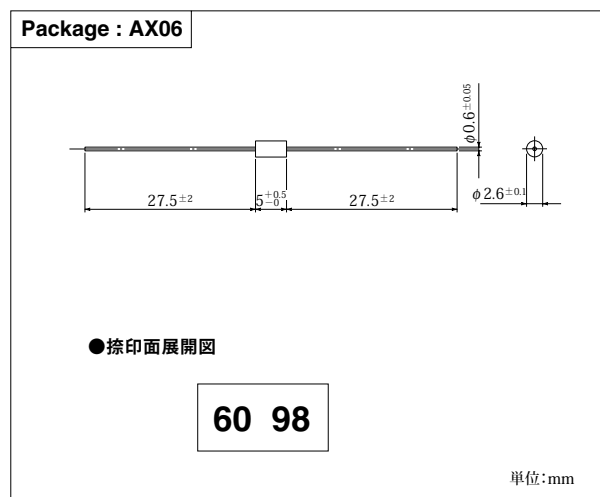


VR-60BP(A)

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

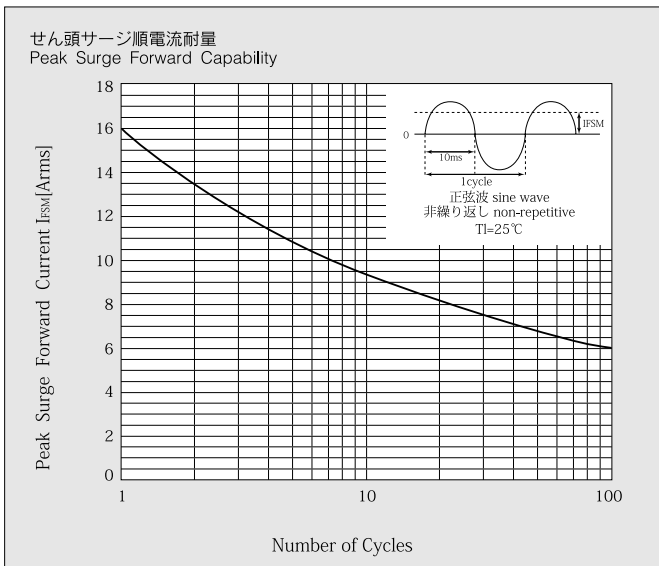
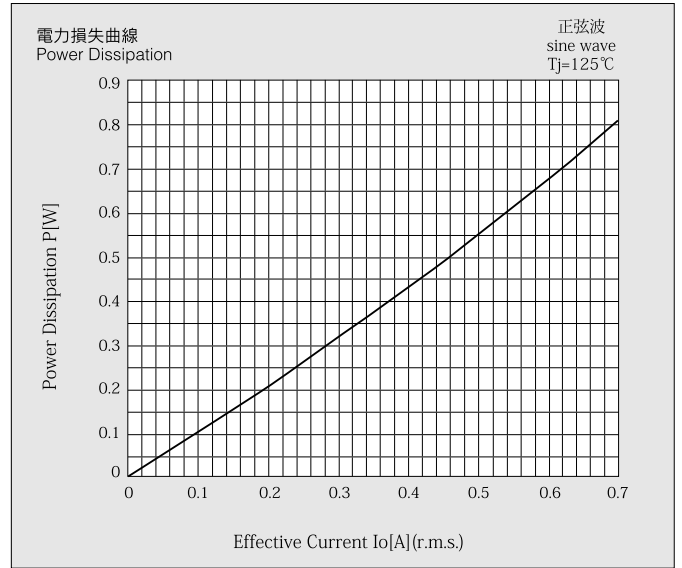
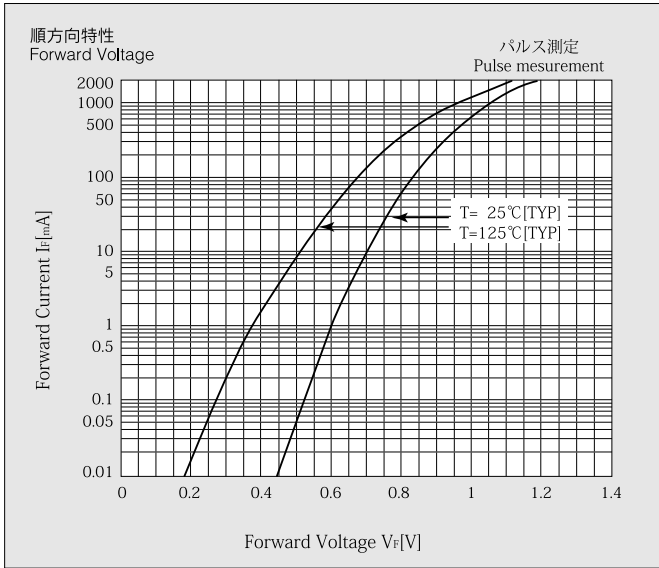
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-30~125	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Junction Temperature	Tj		125	$^\circ\text{C}$
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=40 $^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=40 $^\circ\text{C}$	0.5	Arms
せん頭サーージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz, 正弦波, 非繰り返し, 1 サイクル Tj=25 $^\circ\text{C}$ 50Hz, sine wave, Non-repetitive, 1 cycle, Tj=25 $^\circ\text{C}$	16	Arms

●電気的特性 TI=25 $^\circ\text{C}$ Electrical Characteristics TI=25 $^\circ\text{C}$ (指定のない場合 $T_1=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =1mA	パルス測定 Pulse measurement	MIN 0.550 MAX 0.617	V
		I _F =1.0A		MAX 1.50	
逆電流 Reverse Current	I _R	V=0.2V		MAX 20	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	ガラス・エポキシ基板 glass・epoxy substrate	MAX 156	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
- Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- Typical a statistical average of the devices ability.